

Cesta De Limpeza Úmida Em Ptfé De Alta Pureza, Suporte De Gravação Para Wafer Único De 4 Polegadas, Porta-Máscaras Personalizável

Número do item: PL-CP66



introdução

Cestas de limpeza úmida em PTFE de alta pureza oferecem resistência química excepcional para processamento de wafers semicondutores. Esses suportes de gravação personalizáveis garantem limpeza por imersão sem contaminação e manuseio seguro para substratos delicados em ambientes laboratoriais e industriais exigentes. Entre em contato para soluções de fluoropolímero sob medida.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Limpeza de Wafer Semicondutor	Imersão de wafers de silício em sequências de limpeza RCA (SC-1 e SC-2) para remoção de contaminantes orgânicos e metálicos.	Evita contaminação cruzada e garante processamento de alta pureza.
Gravação Química Úmida	Gravação de precisão de filmes finos (SiO ₂ , Si ₃ N ₄) usando banhos de ácido fluorídrico ou fosfórico em temperaturas elevadas.	Mantém integridade estrutural em ambientes ácidos agressivos.
Processamento de Placa de Máscara	Manuseio e limpeza especializados de fotomáscaras utilizadas na litografia para garantir transferência de padrão sem defeitos.	O encaixe de precisão evita danos por contato na superfície da máscara.
Fabricação de Células Solares	Processamento em massa de wafers de silício para texturização e remoção de vidro de fosfato de silício (PSG).	Alto rendimento e durabilidade em ciclos de produção de alto volume.
Preparo de Vidro Condutor	Limpeza e preparação de vidro revestido com ITO/FTO para fabricação de optoeletrônicos e displays.	Pontos de contato mínimos evitam arranhões em camadas condutoras delicadas.
Desenvolvimento de MEMS	Manuseio de sistemas microeletromecânicos multicamadas durante processos complexos de gravação de camada de sacrifício.	A inércia química garante que microestruturas delicadas não sejam comprometidas.
P&D em Escala Laboratorial	Tratamento de substratos em pequenos lotes em pesquisa acadêmica e industrial para desenvolvimento de novos materiais.	A personalização versátil permite acomodar formatos e tamanhos de substrado não padrão.

Parâmetro	Detalhes da Especificação (Modelo: PL-CP66)
Composição do Material	PTFE (Politetrafluoretileno) Virgem de Alta Pureza 100%
Temperatura Máxima de Operação	+260°C (Contínua)
Temperatura Mínima de Operação	-200°C
Compatibilidade Química	Universal (pH 0-14); Resistente a HF, Água Régia, Solução Piranha
Tamanho Padrão de Substrado	4 polegadas (100mm) - Personalizável para todos os diâmetros
Configuração de Ranhuras	Variantes de wafer único ou múltiplos wafers disponíveis

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Parâmetro	Detalhes da Especificação (Modelo: PL-CP66)	
Profundidade/Largura de Ranhuras	Totalmente personalizável para a espessura e necessidades de estabilidade do substrato	
Design do Cabo	Cabos verticais fixos, removíveis ou articulados (Personalizável)	
Método de Fabricação	Usinagem CNC de Precisão (Zero Contaminação por Moldagem)	
Acabamento de Superfície	Acabamento usinado de alta suavidade e baixa porosidade	